

Przygotowanie podłoża

Bezspoinowy system ociepleniowy może być prawidłowo wykonany wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez podłoże określonych wymagań i sprawdzenia jego nośności. Podłoża zanieczyszczone, nasiąkliwe lub nierówne wymagają w każdym przypadku odpowiedniego przygotowania. Na podłożach o niedostatecznej nośności system ociepleniowy musi być mocowany mechanicznie.

Podłoża, na których występują algi, grzyby lub porosty muszą być w każdym przypadku przygotowane w specjalny sposób. W tym celu ścianę należy oczyścić i poddać działaniu środka StoPrim Fungal. Nie jest konieczne splukanie roztworu z podłoża.

Odpowiednie rozcieńczenie pozwala na dostosowanie środków gruntujących do właściwości każdego podłoża. Po wyschnięciu na powierzchni nie powinien być widoczny połysk.

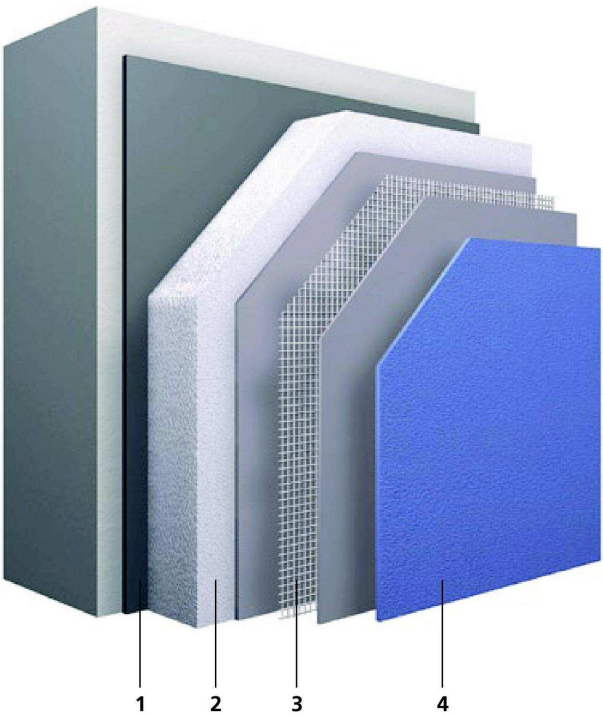
Przygotowanie podłoża przy mocowaniu mechanicznym jest zbędne, ściana musi być jednak sucha.

Tabela podłoży

Podłoże	Przygotowanie podłoża	Gruntowanie
powierzchnia gładka	uszorstnianie	-
wykwity	ścieranie, usuwanie szczotką	-
zawilgocone	usunięcie przyczyn zawilgoce- nia, umożliwienie wyschnięcia	-
tynk na spoiwie organicznym	czyszczenie	-
mchy, algi, grzyby	czyszczenie, bez splukiwania	StoPrim Fungal StoPrim Fungal C
zapyłone, zanieczyszczone	ścieranie, usuwanie szczotką, oczyszczanie ciśnieniowe parą	-
zatłuszczone, zanieczyszczone reszkami środków antyadhezyjnych	czyszczenie ciśnieniowe parą z dodatkiem środków czyszczą- cych, splukanie wodą	-
pokryte łuszczącą się farbą	usuwanie za pomocą środka Sto-Fassadenabbeizer i oczysz- czenie ciśnieniowe parą	-
pokryte kredującym tynkiem	oczyszczenie i gruntowanie	StoPlex W
pokryte kredującą farbą	usuwanie szczotką, oczysz- czenie i gruntowanie	StoPlex W
nasiąkliwe	oczyszczenie i gruntowanie	StoPlex W
powierzchnie osypujące się	oczyszczenie i gruntowanie	StoPrim Micro StoPlex W
pozostałości zaprawy	skucie	-
zgorzel	usuwanie mechaniczne	-
zmurszały, nienośny tynk	usuwanie mechaniczne	-
tynk z ubytkami	rozkucie, wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną	-
nierówności ¹⁾	wyrównanie zaprawą cemen- towo - wapienną (czas wiąza- nia min. 14 dni)	-

¹⁾ < 1 cm przy systemach klejonych
< 2 cm przy systemach klejonych i mocowanych kołkami
< 3 cm przy mocowaniu mechanicznym

Budowa systemu



1 Klejenie - Sto-Baukleber
klej mineralny

2 Ocieplenie - płyta z trudno zapalnego styropianu
(wg PN-EN 13163/2004)

3 Zbrojenie - Sto-Armierungsputz na spoiwie organicznym,
gotowa masa zbrojąca
Siatka Sto-Glasfasergewebe
Alternatywa:
Siatka ekranująca Sto-Abschirmgewebe AES
Alternatywa w technologii QS:
Wersja Sto-Armierungsputz QS dla trudnych warunków
atmosferycznych pow. +1°C.

4 Warstwa wierzchnia Stolit/StoSilco
oparte na spoiwie organicznym, beczementowe, gotowe do
użycia tynki wierzchnie do wszystkich rodzajów podłoży.
Z dodatkiem konserwującym dla poprawy odporności na
oddziaływanie mikroorganizmów (algi, grzyby).
Alternatywa w technologii QS:
wersje Stolit QS i StoSilco QS dla trudnych
warunków atmosferycznych pow. +1°C
(powłoka ochronna: farba elewacyjna
StoSilco Color G / StoLotusan Color G).

Opis systemu

StoTherm Classic
Organiczny system ocieplenia elewacji
z izolacją termiczną ze styropianu
System posiada aprobatę techniczną
AT-15-2599 / 2001 oraz certyfikat CZ ITB-271/02

Zastosowanie

- stare i nowe obiekty
- materiały ściennne: mur (elementy betonowe, wapienno - piaskowe, ceramiczne, z betonu komórkowego), mur licowy i budownictwo drewniane

Właściwości

- wysoka izolacyjność termiczna i odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych
- odporność na oddziaływanie mikroorganizmów (algi i grzyby)
- wysoka odporność na powstawanie rys
- wysoka odporność mechaniczna
- przepuszczalność CO₂ i pary wodnej
- nie rozprzestrzeniający ognia

Wygląd zewnętrzny

- tynki na bazie spoiw organicznych i żywicy silikonowej
- barwienie w systemie StoColor, możliwość uzyskania współczynnika odbicia rozproszonego < 20 %
- profile StoDeco, bonie StoDeco Bossen, płyty Sto-Bossenplatten
- płytki licowe Sto-Flachverblender, płytki klinkierowe

Wykonanie

- beczementowe i gotowe do użytku składniki systemu
- wiele rozwiązań szczegółów
- brak konieczności stosowania zbrojenia diagonalnego, warstw pośrednich i wyrównujących nasiąkliwość
- technologia QS
- racjonalne wykonanie dzięki zastosowaniu technologii maszynowej

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO – PROJEKTOWE “AC-SYSTEM”			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W BIAŁEJ PISKIEJ PRZY UL. SIENKIEWICZA 21	SKALA:	
		DATA: 10. 2009 r.	
TYTUŁ OPRACOWANIA	DETAL SYSTEMOWY		NR RYS.: 17
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY W. BORYSZEWSKI	SUW – 28/ 89	
OPRACOWAŁ	SŁAWOMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWALIBÓG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 p. 1 nr 166/ 76	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS